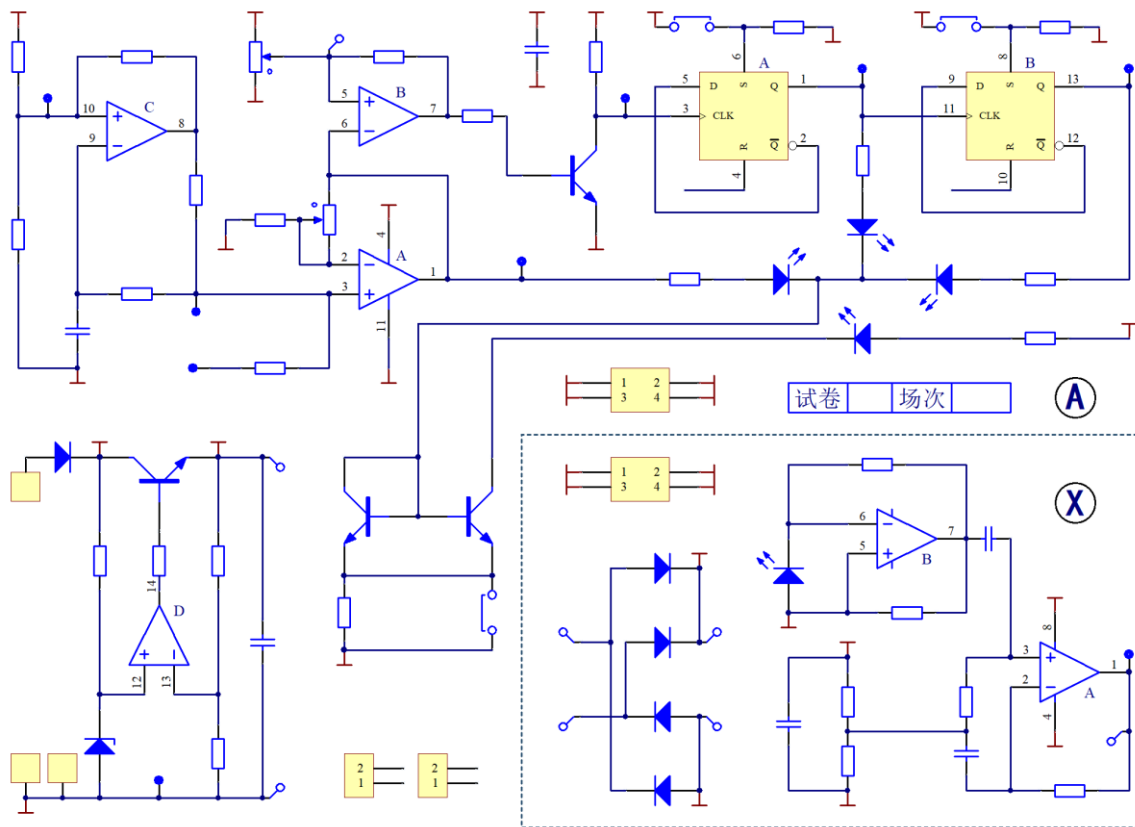


江苏省 2021 年普通高校对口单独招生

电子专业技能考试 技术公开信息说明

一、电子产品的电路原理参考图



二、说明

1. 上图为实际卷面原理图的参考图，整机电路包括单元电路 A 和单元电路 X 两个部分，虚线框内为单元电路 X。上图所示的所有细节部分，适用本次考试所有场次；
2. 套件包括对应实际原理图的 1 块双面印制线路板。该线路板是拼板，装接过程可以随时掰开分离为 A 板和 X 板，不影响后期调试。两块板与两个单元电路一一对应；
3. 待装接元件布置在拼板的正反两面，合理安排装接工序，按照清单及电路板丝印装配信息进行装接。各场次线路板的装配焊接工作量完全相同，其中贴片焊点数占比为 65%；
4. 套件中有 2 只 3362P 单圈电位器，需要使用仪表起子微调，明确顺时针、逆时针调节方向；
5. 套件中有 6 颗 LL-34 封装的两种二极管，此类器件封装的圆环标记侧为阴极标识；
6. 套件中有 4 颗 3528 封装的单色超高亮 LED，该器件封装的缺口侧为阴极标识。该器件 PCB 封装较为紧凑，以便居中贴底装配。该器件为易损器件，焊接温度和时间应合理控制，操作时正面透明透镜不得受力挤压。调试过程中，当器件发光亮度较高时，请勿直视或持续观察；
7. 套件中有 1 颗单色发光二极管，必须加配套的隔离柱垫高后再贴底装配焊接；
8. 套件中所有贴片电阻为 0805 封装，均为 $\pm 1\%$ 精度，允许使用放大镜；
9. 套件无冗余件，外观相似的个别元件可按照数量区分，清点确认无误后再焊接；未开始焊接前，材料有残缺的填缺漏申请经核实后立即换发；开始焊接后需要更换材料的，请及时填损失申请；损失材料换发在开考 30 分钟后开放，按实际换发时元件个数扣分，每个 1 分；
10. 顺序调试到最后项时，在整机组装调试中，须按要求组装后调试。组装后 X 板和 A 板无法分开，不可恢复到首次调试时的结构。受固定结构影响有 2 分题无法复核，试卷中有明显提示。